

OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL-SMT 5.08HC/12/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Conector macho resistente a altas temperaturas, embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

Tipo	SL-SMT 5.08HC/12/90F 3.2SN BK BX
Código	1837730000
Versión	Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
GTIN (EAN)	4032248347544
U.E.	24 Pieza
Valores característicos del producto	IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A
Embalaje	Caja

OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL-SMT 5.08HC/12/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	71,12 mm	Anchura (pulgadas)	2,8 inch
Altura	11,7 mm	Altura (pulgadas)	0,461 inch
Altura construcción baja	8,5 mm	Profundidad	12 mm
Profundidad (pulgadas)	0,472 inch	Peso neto	5,59 g

Especificaciones del sistema

Familia del producto	OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08	Tipo de conexión	Conexión de tarjetas
Montaje sobre placas c.i.	Conexión por soldadura THT/THR	Paso en mm (P)	5,08 mm
Paso en pulgadas (P)	0,2 inch	Angulo de salida	90°
Número de polos	12	Número de terminales de soldadura por polo	1
Longitud del terminal de soldadura (l)	3,2 mm	Tolerancia de longitud del pin de soldadura	0 / -0,3 mm
Tolerancia de posición del terminal de soldadura	± 0,15 mm	Dimensiones del pin de soldadura	d = 1,2 mm, octogonal
Diámetro de la perforación (D)	1,5 mm	Tolerancia de diámetro de la perforación (D)	+ 0,1 mm
L1 en mm	55,88 mm	L1 en pulgadas	2,2 inch
Número de series	1	Número de filas de polos	1
Codificable	Sí	Ciclos de enchufado	25
Fuerza de inserción/polo, máx.	9 N	Fuerza de extracción/polo, máx.	7 N

Datos del material

Materiales aislantes	LCP GF	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Grupo de materiales aislantes	IIla
CTI	≥ 175	Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
GWIT	930 °C	GWFI	960 °C
Material de contacto	CuMg	Superficie de contacto	estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura	1-3 µm Ni / 2-4 µm Sn mate	Estructura de capas del contacto del conector	1-3 µm Ni / 2-4 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min.	-25 °C	Temperatura de almacenamiento, max.	55 °C
humedad relativa máx. de almacenamiento	80 %	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C	Gama de temperatura, montaje, min.	-30 °C
Gama de temperatura, montaje, max.	100 °C		

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984	Corriente nominal, n.º de polos mín. (Tu=20 °C)	27,5 A
Corriente nominal, n.º de polos máx. (Tu=20 °C)	19 A	Corriente nominal, n.º de polos mín. (Tu=40 °C)	24 A
Corriente nominal, n.º de polos máx. (Tu = 40 °C)	16,5 A	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	400 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	320 V	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	4 kV	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	4 kV		

**OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
SL-SMT 5.08HC/12/90F 3.2SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Datos nominales según CSA**

Instituto (CSA)



Núm. de certificación (CSA)

200039-1176845

Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V

Tensión nominal (Use group D / CSA) 300 V

Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 18,5 A

Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 18,5 A

Referencia para valores de homologación

Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (UR)



Núm. de certificación (UR)

E60693

Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V

Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 300 V

Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 18,5 A

Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 10 A

Referencia para valores de homologación

Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje	Caja	Longitud de VPE	50 mm
Anchura VPE	95 mm	Altura de VPE	175 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637	ETIM 6.0	EC002637
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-04
eClass 6.2	27-26-07-04	eClass 7.1	27-44-04-02
eClass 8.1	27-44-04-02	eClass 9.0	27-44-04-02
eClass 9.1	27-44-04-02		

OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 SL-SMT 5.08HC/12/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Notas

Indicaciones

- Contactos bañados en oro bajo pedido
- Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
- Diámetro de la perforación D = 1,4+0,1 mm
- Diámetro de la perforación del soldador D = 1,5 + 0,1 mm a partir de 9 polos
- P en el dibujo = paso
- Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.

Conformidad con IPC

Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería

[WSCAD](#)

Datos de ingeniería

[STEP](#)

Folleto/catálogo

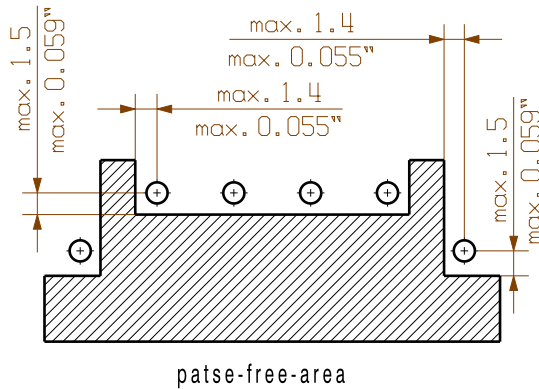
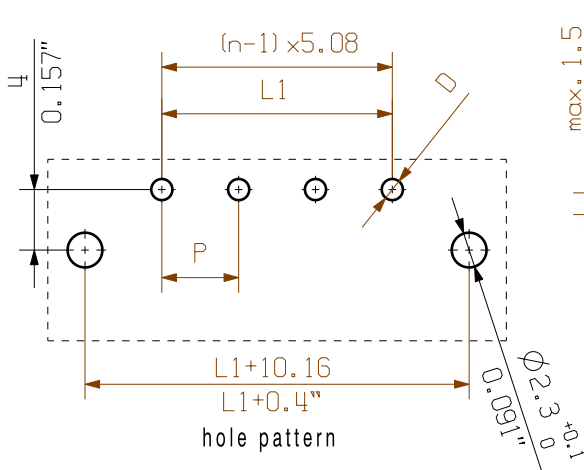
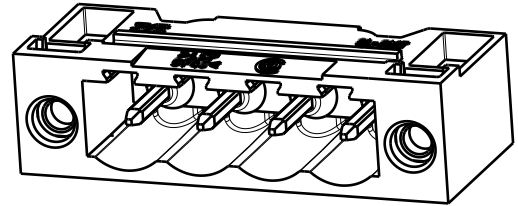
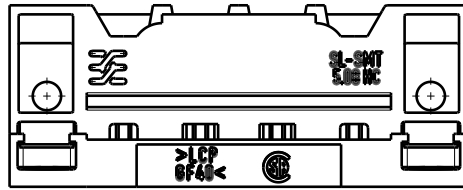
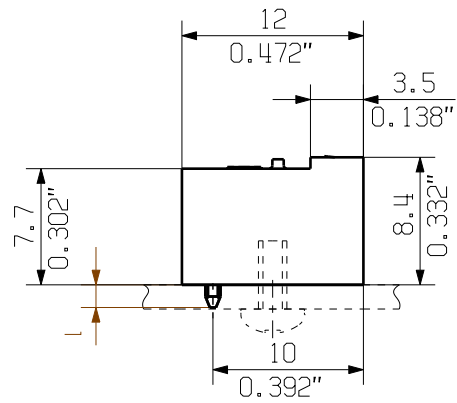
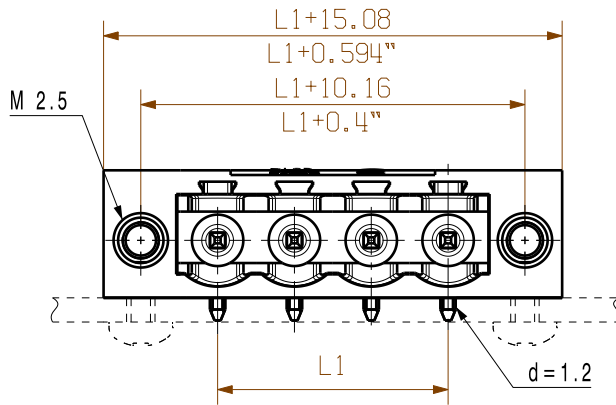
[FL DRIVES EN](#)
[MB SMT EN](#)
[FL DRIVES DE](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL BUILDING SAFETY EN](#)
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL HEATING ELECTR EN](#)
[FL APPL INVERTER EN](#)
[FL BASE STATION EN](#)
[FL ELEVATOR EN](#)
[FL POWER SUPPLY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Homologación/certificado/documento de conformidad

[Declaration of the Manufacturer](#)

Libro blanco sobre SMT

[Download Whitepaper](#)



D = 1.4/0.055" or 1.5/0.059" (REFLOW SOLDERING)
RECOMMENDATION FOR AUTOMATIC ASSEMBLY
(1.4mm FOR n=2...8 / 1.5mm for n=9...24)

n = POLZAHL/NO OF POLES

P = RASTER/PITCH

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.

The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.

The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.

Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

shown: SL-SMT 5.08HC/04/90F

24	116.84	4.600	+/- 0.2
23	111.76	4.400	
22	106.68	4.200	
21	101.60	4.000	
20	96.52	3.800	
19	91.44	3.600	+/- 0.15
18	86.36	3.400	
17	81.28	3.200	
16	76.20	3.000	
15	71.12	2.800	
14	66.04	2.600	+/- 0.1
13	60.96	2.400	
12	55.88	2.200	
11	50.80	2.000	
10	45.72	1.800	
9	40.64	1.600	+/- 0.1
8	35.56	1.400	
7	30.48	1.200	
6	25.40	1.000	
5	20.32	0.800	
4	15.24	0.600	+/- 0.1
3	10.16	0.400	
2	5.08	0.200	
1	tolerance		

4.5	0.1/-0.3
3.2	0.1/-0.3
2.1	0.1/-0.3
1.5	-0.3
1	tolerance

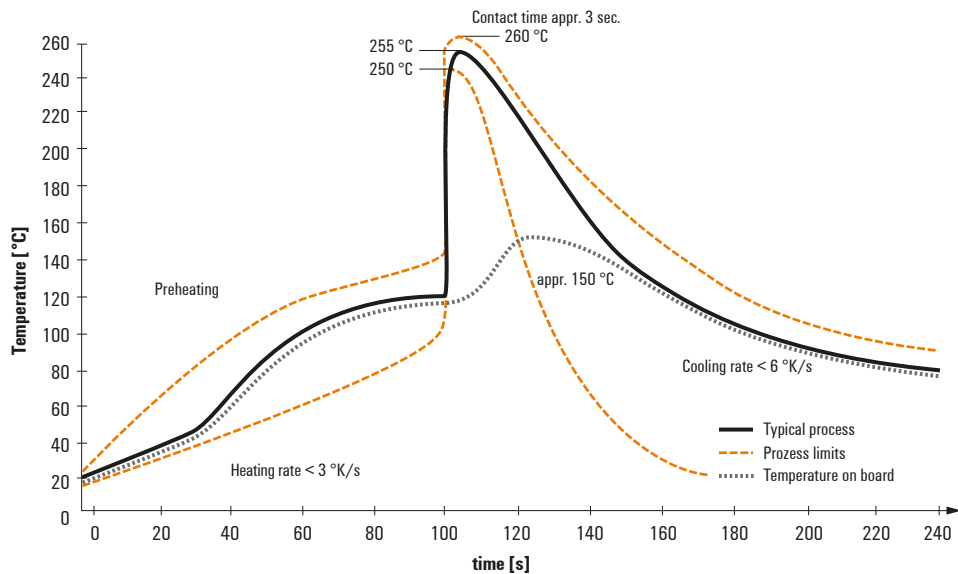
no of poles L1 [mm] L1 [inch] tolerance L1

	DIN ISO 2768-m		106339/4 30.07.18 HERTEL_S 00			Cat.no.: .	
	Modification					2 33262 31	
		Date	Name		SL-SMT 5.08HC/.. /90... STIFTELEISTE MALE HEADER		
Scale: 2:1		Drawn	29.11.2007	HELIS_MA	Product file: SL-SMT 5.08		
Supersedes: .		Responsible		HERTEL_S	7280		
		Checked	01.08.2018	KOCH_JG			
		Approved		LANG_T			

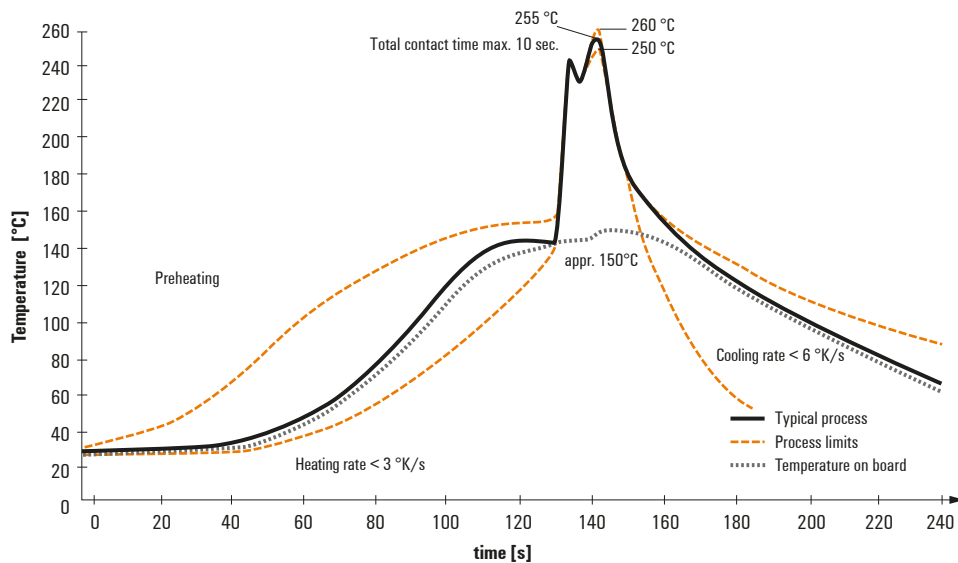
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

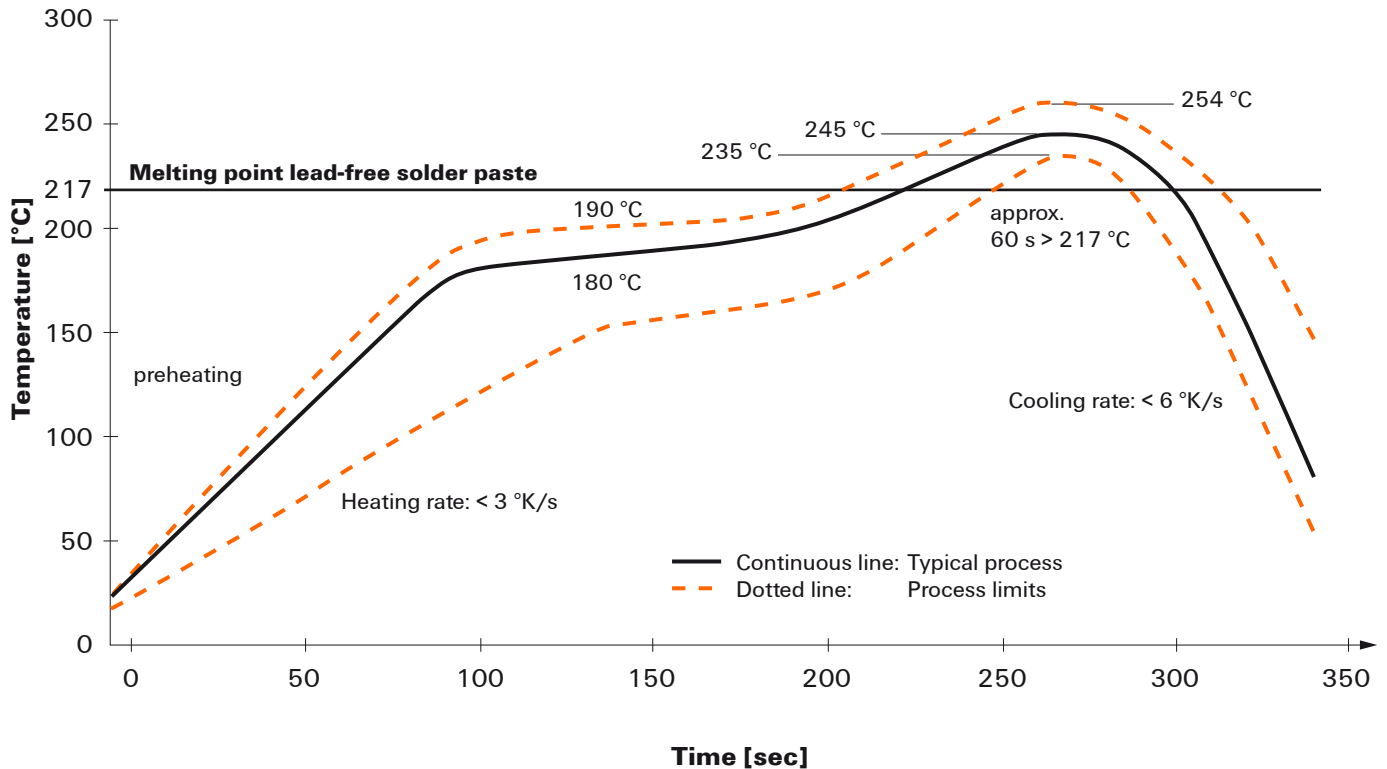
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.